

PRESSE-INFORMATION 09-2025

Call for Papers: EBL 2026 – 13. DVS/GMM-Tagung „Sicherung der europäischen Wertschöpfungsketten“ vom 24.–25. Februar 2026 in Fellbach

Düsseldorf, 24. Juni 2025. Die 13. Fachtagung „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten“ (EBL) findet vom 24. bis 25. Februar 2026 in der Schwabenlandhalle in Fellbach statt. Unter dem Leitthema „Sicherung der europäischen Wertschöpfungsketten“ laden die Veranstalter DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. – und die GMM – Fachgesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik im VDE – zur Einreichung von Fachbeiträgen ein.

Das Embedding elektronischer Komponenten, die Hochfrequenztechnik, die Leistungselektronik und die Digitalisierung sowie für Anwendungen der Photonik bis hin zum Quantencomputing sind ohne moderne Baugruppenteknologie nicht möglich. Die aktuellen Herausforderungen globaler Lieferketten – von geopolitischen Konflikten bis zu Rohstoffengpässen – erfordern zwangsläufig auch resiliente und souveräne europäische Wertschöpfungsketten. Die EBL 2026 bietet eine Plattform für den fachlichen Austausch, die Präsentation innovativer Lösungen sowie strategische Impulse für Industrie, Forschung und Politik.

Call for Papers:

Interessierte Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Fachleute aus der Industrie sind eingeladen, bis zum 30. September 2025 ihre Beiträge einzureichen. Die besten Beiträge werden auf der EBL 2026 vorgestellt und diskutiert.

Themen der Tagung sind:

- Digitalisierung, Machine Learning, KI
- Intelligente Systemkonzepte, Designtools, Tests und Simulation
- Neue Materialien
- Energieeffizienz, Thermisches Management
- Funktions- und Schaltungsträger
- Modul- und Baugruppenfertigung
- AVT, Weichlöten, Kleben, Sintern, Bonden, Lasern
- Prozesssimulation und -steuerung
- Traceability, Compliance, Produkt- und Prozesssicherheit, Technische Sauberkeit

- Testmethoden, Zuverlässigkeit und Analytik
- Trends, Nachhaltigkeit, Additive Fertigung
- Integrierte Funktionen und Schaltungsträger, Embedded Components, Advanced Packaging

Nachwuchsförderung im Fokus:

Auch in diesem Jahr wird der EBL-Nachwuchspreis vergeben. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler präsentieren sich in einer eigenen Nachwuchs-Session. Die besten Beiträge werden mit einer Urkunde und einem Preisgeld unter großem Interesse möglicher potenzieller Arbeitgeber ausgezeichnet. Als bedeutendste deutschsprachige Konferenz im Bereich der Aufbau- und Verbindungstechnik in der elektronischen Baugruppenfertigung vereint die EBL Fachkompetenz, Innovation und Networking unter einem Dach.

Links zur [Vortragseinreichung](#) und zur [EBL-Webseite](#)

Organisatorischer Kontakt:

Sabrina Tank

sabrina.tank@dvs-media.info

0211 1591-141

Fachlicher Kontakt:

Lisa Rauscher

lisa.rauscher@dvs-home.de

0211 1591-120

Über den DVS

Der DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. ist ein technisch-wissenschaftlicher Verband, der sich mit mehr als 125 Jahren Erfahrung umfassend für die rund 250 verschiedenen Verfahren des Fügens, Trennens und Beschichtens engagiert. Das Herzstück aller DVS-Aktivitäten ist die technisch-wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit. Sie steht für die anhaltend enge Verknüpfung von Inhalten und Ergebnissen aus den Bereichen Forschung, Technik und Bildung. Die Beteiligungsgesellschaften des DVS verarbeiten die Ergebnisse aus dem Verband und präsentieren sie mit ihren eigenen Schwerpunkten nach außen. Die Hauptgeschäftsstelle des gemeinnützig anerkannten Verbandes ist in Düsseldorf. Die rund 17.000 Mitglieder werden durch die DVS-Landesverbände und DVS-Bezirksverbände direkt vor Ort betreut. Gemeinsam setzen sich alle Mitglieder des Verbandes für eine in jeder Hinsicht zukunftsfähige Fügetechnik ein.